

产品规格书

产品名称: _____

产品型号: 5BB4HD

一、产品分类：

产品类别型号：_____ 类别名称：_____

属 ESD 产品 MSD 产品 关键产品 安全件 EMC 关键件 无铅产品

(以上由我司认定人员填写)

产品型号：_____ 5BB4HD _____

二、包装：

- a) 包装应防震、防潮、防压、无破损，并注明允许堆叠层数。
- b) 内包装上应有 ESD 标志，采用屏蔽型好静电袋包装。
- c) 内包装应有出厂检验合格证，注明生产日期、产品规格型号、那包装数量。
- d) 外包装上应有制造厂名称、产品规格型号、内包装数量。
- e) 采用包装： 散件 塑料管 纸袋盘卷 塑料盘带。

。

三、外观：

外观	商标，型号	商标同产品型号一致，标示清晰，无断符、漏眼印、残留现象
	引脚	无氧化、发黑、露铜、粘污现象
	镀层厚度	引脚镀银0.4-0.45μm,引脚镀锡1-10μm

四、包装标志：

包装标识包括：P/N（产品型号）、TYPE（产品类型）、DATE（包装日期）、QTY（产品数量）等。

客户名称：	_____
客户料号：	_____
规格型号：	_____
订 单 号：	_____ XXXXXX _____
数 量：	_____ XXXXPCS _____
日 期：	_____ XXXXXX _____
箱 号：	_____ 第 X 箱/共 XX 箱 _____

五、安全认证:

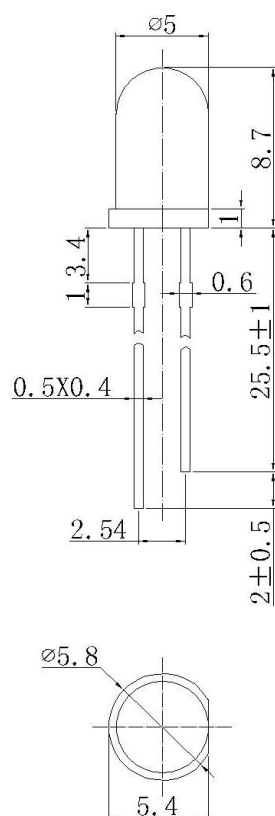
<u>ISO9001</u>	<u>RoHS</u>	<u>ISO14001</u>
00111Q29243R1L/4200	E12053014904C	00111E21692R0L/4200

六、元器件引脚定义及元器件封装外形尺寸图:

元器件引脚定义图

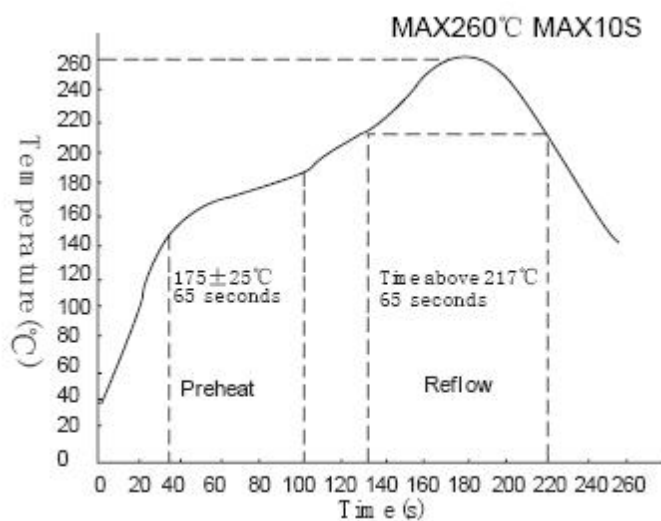


元器件封装尺寸图



七、可焊性

a) 波峰焊条件



b) 烙铁焊接温度要求：温度约 350°C，焊接时间约 2S。

c) 可焊性试验条件：温度约 240~250°C，试验时间为 5S，要求试验后测试电性能正常，外观无不良。

七、光电参数：

测试条件：温度 25° C

相对湿度：45%~75%

正向浪涌电流	反向暗电流				正向电流				功耗	工作温度范围
150mA	10 μ A				20mA				90Mw	-40°C to 85°C
存储温度范围	正向压降				法向光强				峰值波长	
-40°C to 100°C	MIN	TYPE	MAX	UNIT	MIN	TYPE	MAX	UNIT	460-465nm	
	3.0	3.25	3.3	V	4000		5000	mcd		

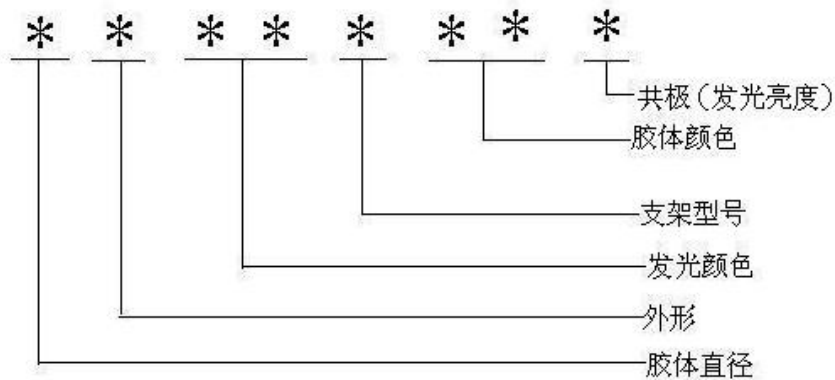
八、关键材料 BOM 清单

序号	物料名称	型号规格	提供厂商
1	绝缘胶	911	光之谷
2	环氧树脂	TX400-9A/B	江苏天阴

3	芯片	10*12	路美
4			

九、元器件型号的命名规则和本体标识：

1. 产品型号 (P/N) 命名规则说明例如下：



2. 元器件标识：

(无铅产品必须注明无铅识别方法)

供应厂商	
供应商编号	无
P/N(外包装标识)	无
本体标识 (本体标识中必须 含有右图所有标 识)	无

十、存储条件：存储温度： -40℃---+80℃

十一、 使用条件：工作环境温度:-40℃---+80℃

十二、 运输要求： 1.箱体上不易压重物
2. 正面朝上
3. 不易受潮

十三、 可靠性试验：

序号	测试项目	测试条件	测试持续时间	判定
1	寿命测试	Ta=25℃±5℃, IF=20mA	1000 小时	合格
2	热冲击测试 t	-10℃±5℃←→+100℃±5℃ 5min. 10sec. 5min.	100 循环	合格
3	冷热循环测试	-55℃±5℃←→+85℃±5℃ 30min. 5min. 30min.	100 循环	合格
4	高温高湿测试	Ta=85℃±5℃ RH =85%±0.5 %RH	240 小时	合格
5	高温贮存测试	Ta=100℃±5℃	1000 小时	合格
6	低温贮存测试	Ta=-55℃±5℃	1000 小时	合格
7	抗焊接热度	Ta=260℃±5℃	5 秒	合格
8	引脚折弯	负荷 2.5 牛顿(0.25 千克) 0° ~ 90° ~ 0°	3 回合	合格

十四、 出货不良率：出货合格率为 100%，不良率为 0ppm。

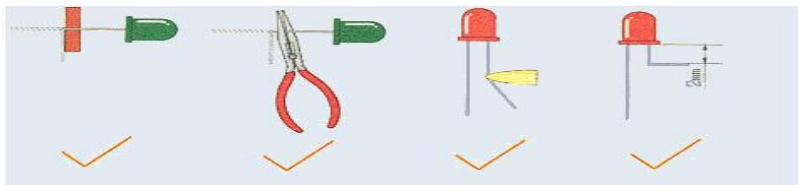
十五、 使用注意事项：

1、清洗

当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色，如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过 3 分钟。

2、引脚装配

- (1) 必需离胶体 2 毫米才能折弯支架。
- (2) 支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
- (3) 支架成形必须在焊接前完成。
- (4) 支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
- (5) 焊接必须在正常温度下进行，当 LED 正常焊接到 PCB 板上后，应尽量避免在 LED 引脚处施加机械压力。



3、静电防护

静电和电流的急剧升高将会对 LED 产生损害，KENTO 系列产品使用时请使用防静电装置，如防护带和手套。

注意：使用时人体放电模式 HBM<1000V；机器放电模式<100V。